

イビデン株式会社 (証券コード:4062)

個人投資家向け 会社説明会資料

2026年 7月 18日



01

会社概要と強み

02

ICパッケージ基板とAI半導体

03

電子事業の概況

04

イビデンの成長戦略

05

企業価値向上の取り組み



01

会社概要と強み



会社概要:ひとめで分かるイビデン

東証プライム上場

時価総額7兆円

2026年7月1日時点

創業114年

証券コード
4062

2025年11月に日経平均(日経225)
構成銘柄に組入



10年間で37倍に拡大
(2016年7月末は1,866億円)



大正元年(1912年)創業
祖業は水力発電事業

現在の事業は3つ

- ① 電子
- ② セラミック
- ③ その他

現在は半導体部品が主体の
電子事業が最大の収益源

海外売上高70%以上



複数の海外半導体
メーカーが取引先

世界シェア※約80%

※AIデータセンター用GPUのICパッケージ基板



AIデータセンター用途の
半導体部品(ICパッケージ基板)が高成長

事業の強み:イビデン3つの特徴

□ 当社の強みは「高度な技術力」「変化への対応力」「新たな成長源を育む企業文化」

100年を超える挑戦の歴史の中で
習得した**技術力**と**対応力**

電力事業から建材事業へ

建材事業から電子事業へ

新たな成長源を育む
企業文化

高度な技術力

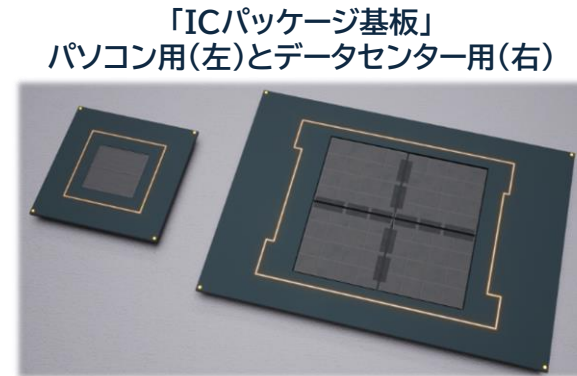
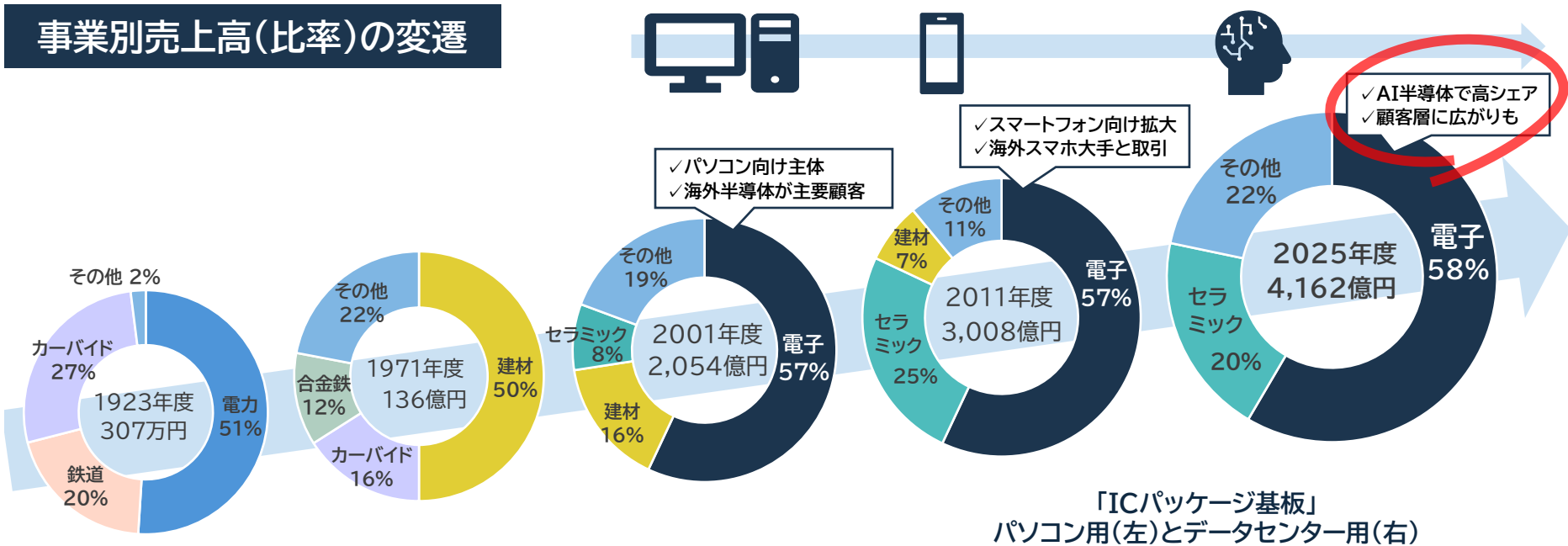
変化への対応力

新たな成長源を育む
企業文化

主力事業:変化と挑戦の中で生まれた電子事業

- 時代の変化を機会と捉え、事業創出を繰り返し成長を続けてきた
- 現在は「電子事業」が主力。データセンター向けのAI半導体用「ICパッケージ基板」が成長を牽引

事業別売上高(比率)の変遷



02

ICパッケージ基板とAI半導体

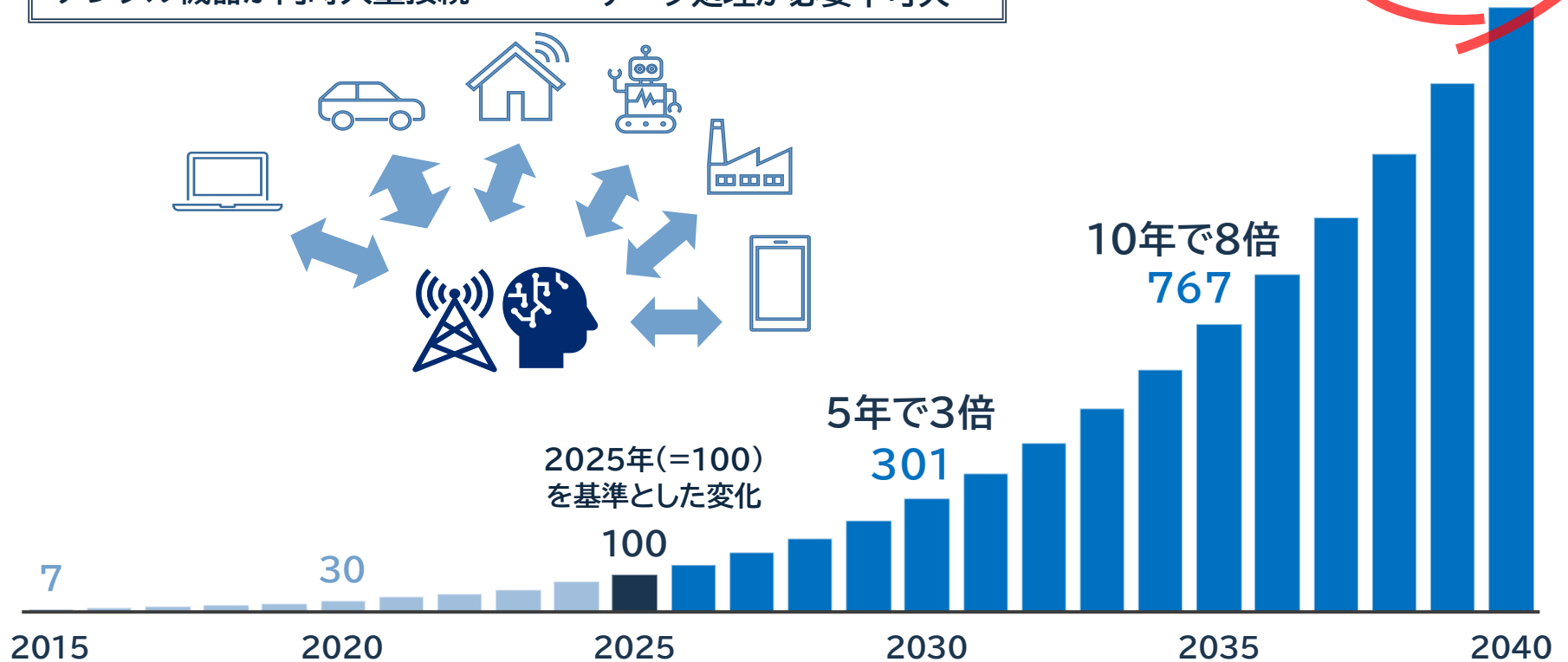
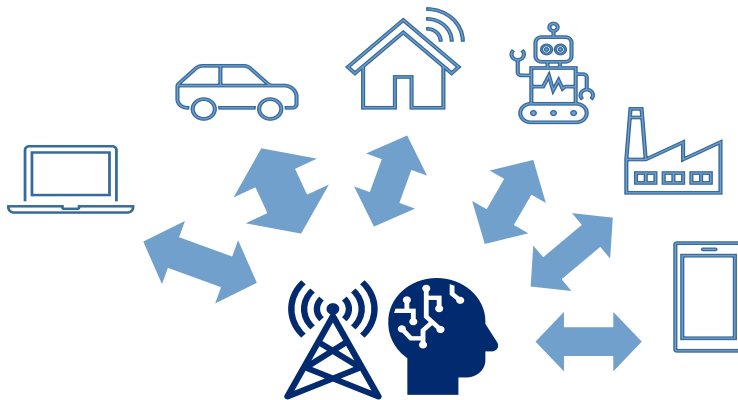
AI半導体市場: データ処理量の膨張で需要が拡大

- AIの社会実装が進むことで世界のデジタルデータの処理量が急増する未来が展望される
- AI半導体市場はデータ膨張に備えるデータセンター投資によって長期的に拡大する見通し

世界のデジタルデータ処理量の推移

※ 民間調査会社データ等を参考とした当社予想

AI社会ではデータセンターにデジタル機器が同時大量接続 = データセンターによる膨大なデータ処理が必要不可欠



ICパッケージ基板:半導体(ICチップ)を動かす電子部品

- パソコンやサーバーで必要不可欠な半導体(ICチップ)の性能を引き出すのはICパッケージ基板
- ICパッケージ基板は、ICチップの保護や電気信号の伝達などを担う中核電子部品

半導体(ICチップ)とICパッケージ基板のイメージ図

ICチップ(集積回路)

ICパッケージ基板

インターポザー

複数のICチップ(集積回路)



パソコン

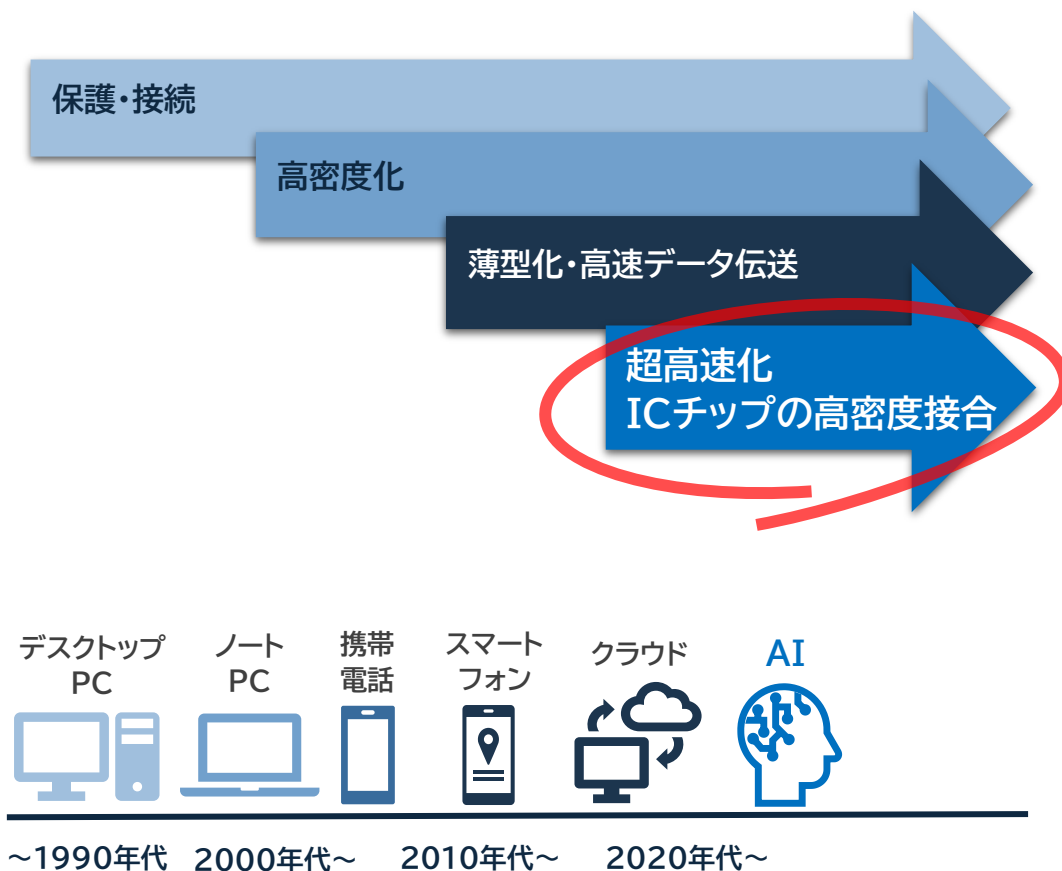


(AI)サーバー(データセンター等)

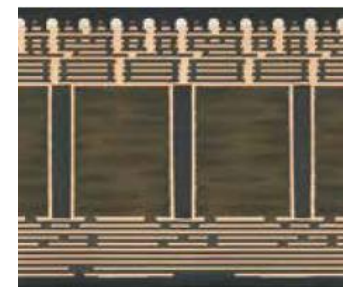
ICパッケージ基板: AI半導体向けの性能は高難度

- AI半導体では、ICパッケージ基板に高難度な性能(超高速・省電力・放熱)が求められる
- 当社は独自技術で、この難しい課題を解決しAI半導体市場において高いシェアを獲得

ICパッケージ基板に求められる性能の変遷



最先端品の技術トレンド

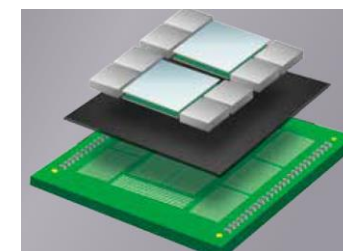
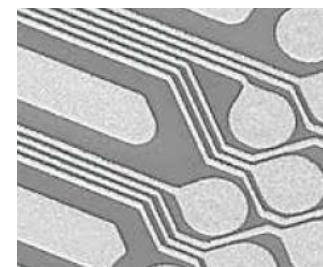


◀ 多層化

データセンター向け
ICパッケージ基板の
断面図

微細化 ▶

データセンター向け
ICパッケージ基板の
内層配線の拡大図



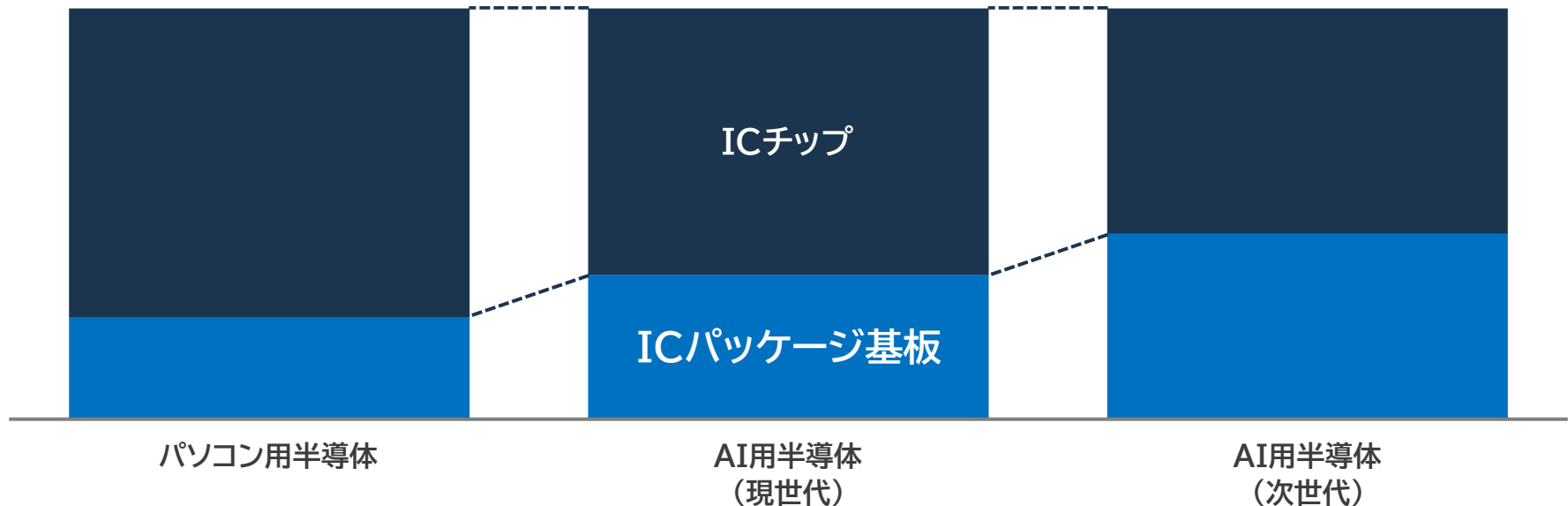
◀ チップレット

複数に分割した
ICチップの機能を
ICパッケージ基板で
統合する方法

AI半導体:ICパッケージ基板の付加価値が拡大基調

- AI半導体の高度な要求性能を満たすため、ICパッケージ基板の役割も高度化(付加価値向上)
- 高度な要求性能に対応できるICパッケージ基板メーカーは当社筆頭にごく少数に限られる

半導体におけるICパッケージ基板とICチップの付加価値の変遷(イメージ)



ICパッケージ基板
のサプライヤー数

多

高度な要求性能に対応できる企業のみ残存し市場が寡占化

少

ICパッケージ基板
の付加価値

少

市場の寡占化でごく少数の企業が多く利益を獲得可能に

多

03

電子事業の概況



電子事業:AI半導体用ICパッケージ基板で高シェア

※ AIデータセンター向け半導体(GPU)の高機能ICパッケージ基板でのシェア

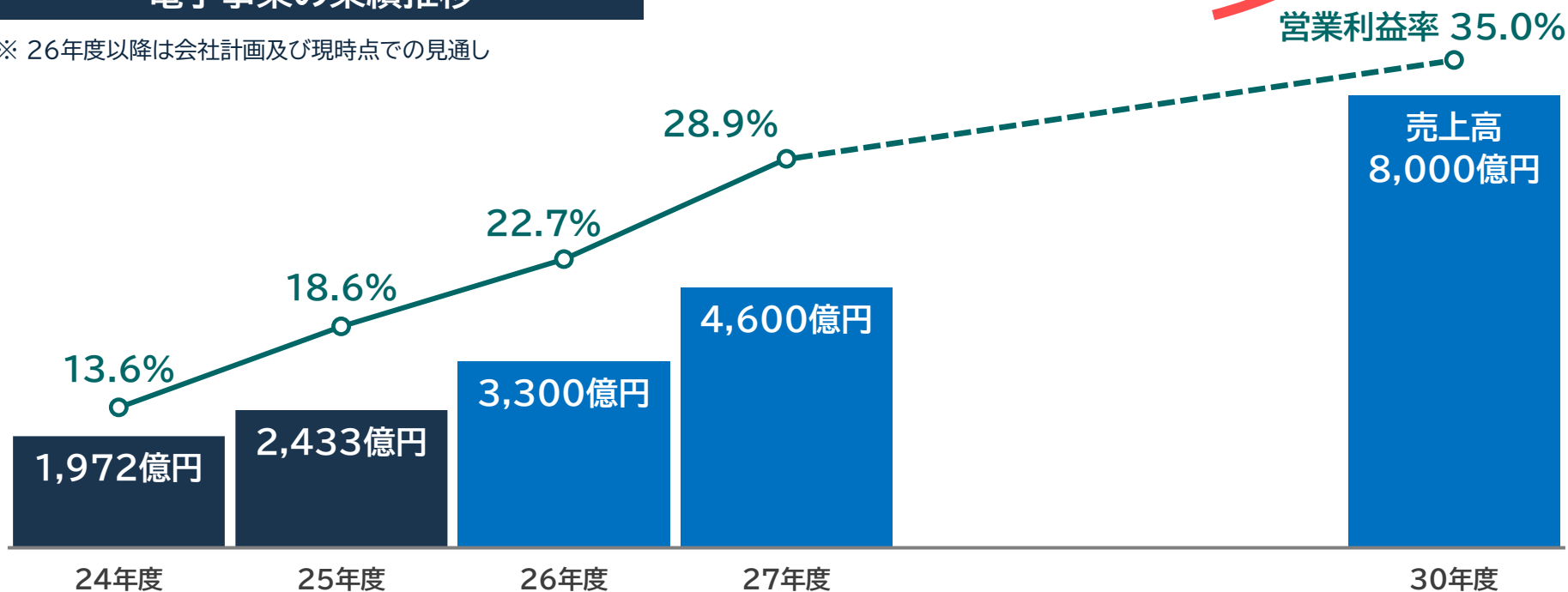
- AI半導体用ICパッケージ基板で世界トップシェアを握る(※推定 約80%)
- AI半導体市場の拡大に伴い、既存顧客との取引拡大だけでなく、新たな顧客も獲得

AIデータセンター用半導体の
ICパッケージ基板でトップシェア

約80%
(当社推定、26年3月時点)

電子事業の業績推移

※ 26年度以降は会社計画及び現時点での見通し



電子事業:選ばれ続ける3つの理由

□ AI半導体用ICパッケージ基板での高シェアも「高度な技術力」「スピード」「積極投資」が決め手に

当社のICパッケージ基板が選ばれ続ける理由

1

高度な技術力

市場にまだない製品を創り出す力

2

スピード

新製品投入までが速く追随を許さない

3

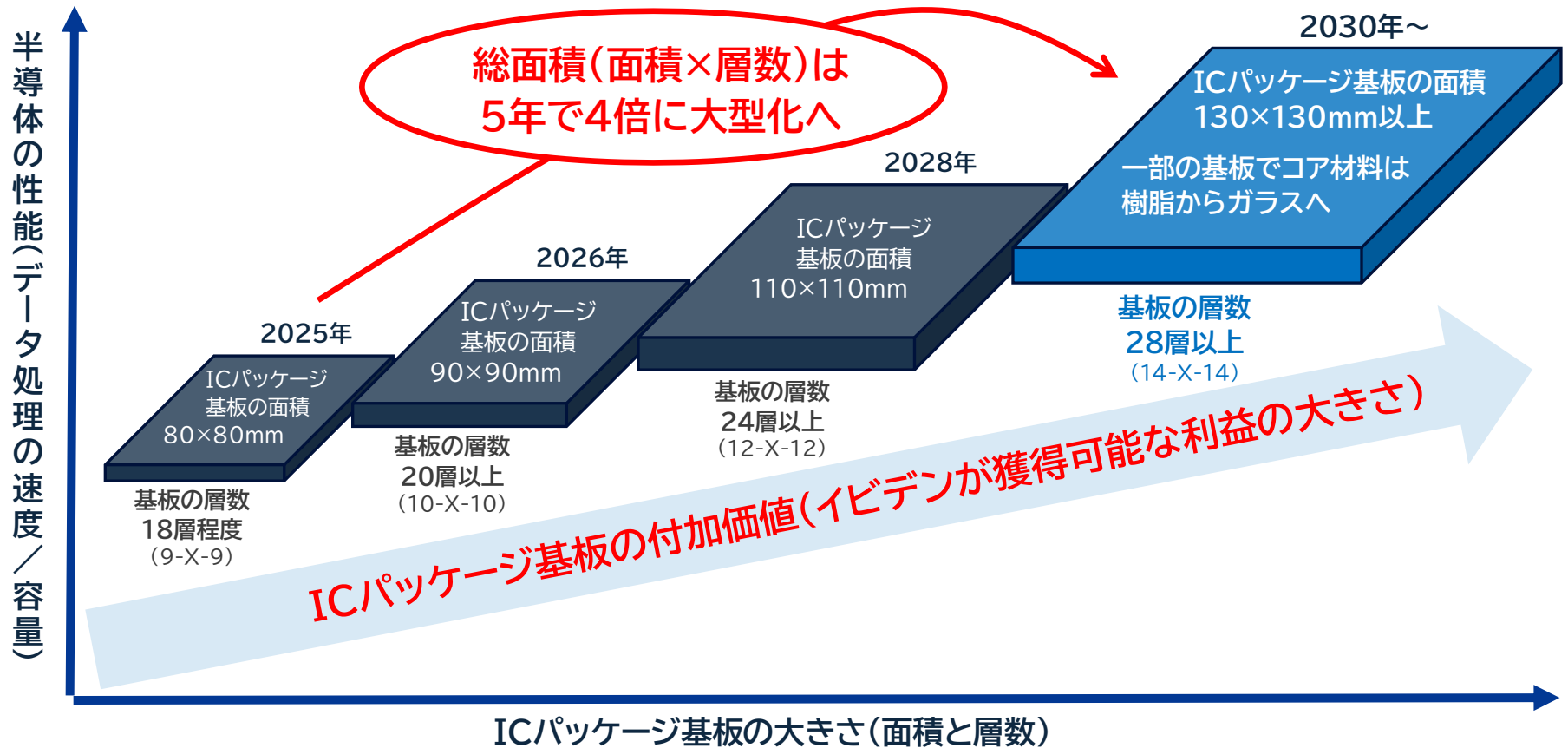
積極投資

果敢な追加投資で商機拡大に対応

電子事業:2030年以降の最先端技術にも対応

- ICパッケージ基板に求められる技術的な難易度は一段と増す見通し(大型化、多層化、内蔵化)
- 当社は最先端の技術開発に携わり続け、ハイエンドのICパッケージ基板での優位性を保つ

ICパッケージ基板の進化トレンド



04

イビデンの成長戦略

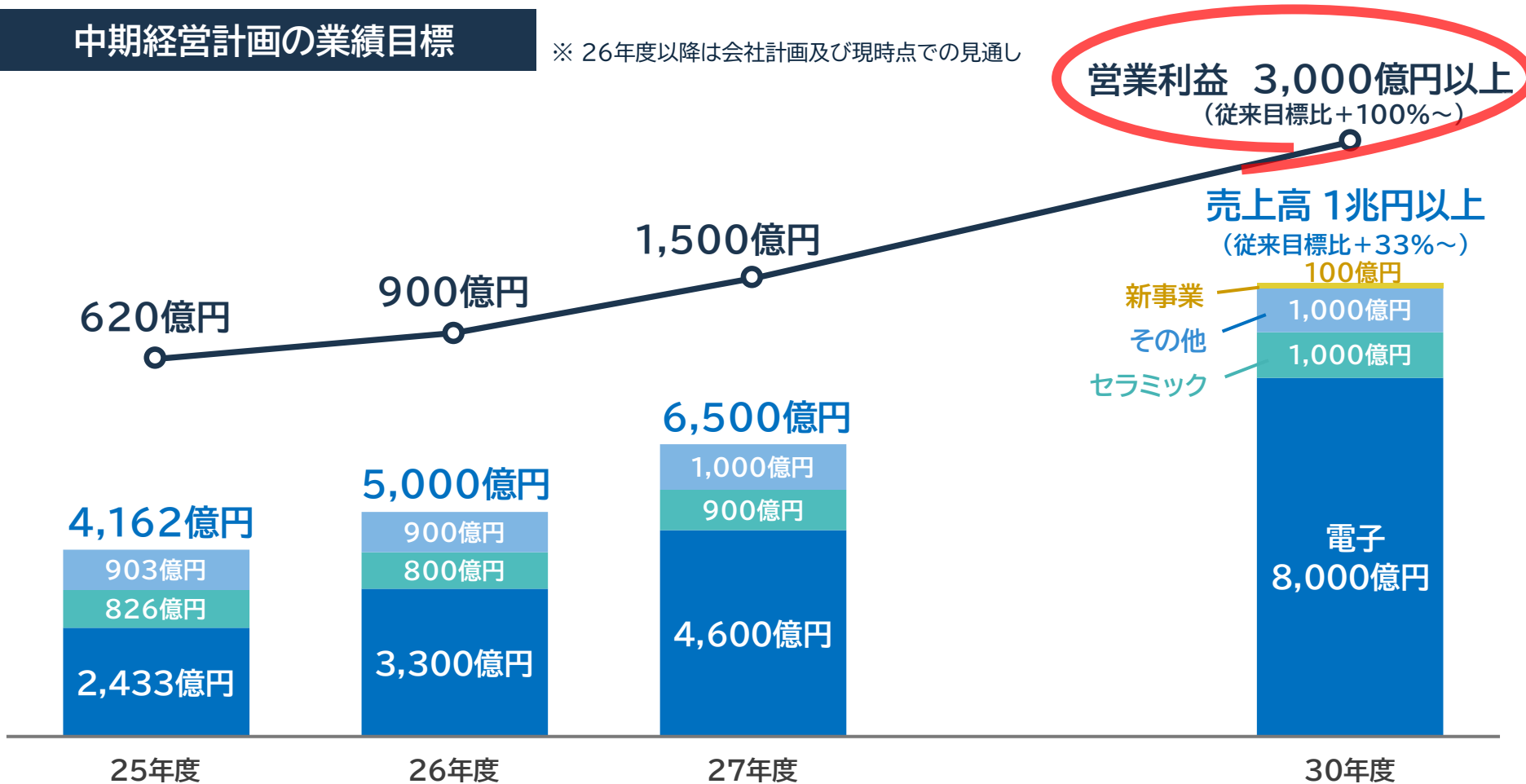


中期経営計画:2030年度に営業利益3,000億円以上へ

- 中期経営計画では30年度に売上高1兆円以上、営業利益3,000億円以上を目指す
- 電子事業でAI半導体関連の成長余地が更に広がったと判断し、業績目標を大幅に引き上げ

中期経営計画の業績目標

※ 26年度以降は会社計画及び現時点での見通し



成長戦略: AI半導体用ICパッケージ基板を増産

- AI半導体用ICパッケージ基板の需要は当面の間、急ピッチで拡大し続ける見通し
- 当社はAI半導体用ICパッケージ基板の生産能力の拡張を進め、事業拡大へつなげる

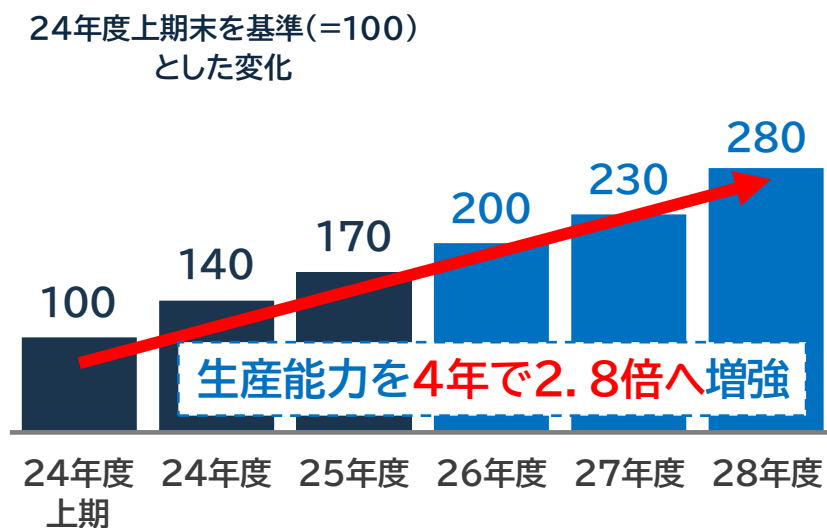
AI半導体用ICパッケージ基板の需要見通し

※ 民間調査会社データ等を参考とした当社予想



イビデンのICパッケージ基板生産能力

※ 各期末時点のAI半導体用ICパッケージ基板の生産能力
26年度以降は会社計画及び現時点での見通し



成長戦略: AI半導体用ICパッケージ基板を増産

- 足元では河間事業場(約2,200億円)、大野事業場(約2,800億円)を中心に生産能力を拡張
- 設備投資は26~27年度にかけ高水準となるが、旺盛な需要に応えるための追加投資も検討

AI半導体用ICパッケージ基板の増産計画

事業所	河間(がま)事業場
投資額	約2,200億円 (Cell6 ※画像参照)
稼働時期	2027年度より順次稼働し量産開始

事業所	大野事業場
投資額	約2,800億円 (Cell8 ※画像参照)
稼働時期	2027年度より順次稼働し量産開始

河間事業場 Cell6

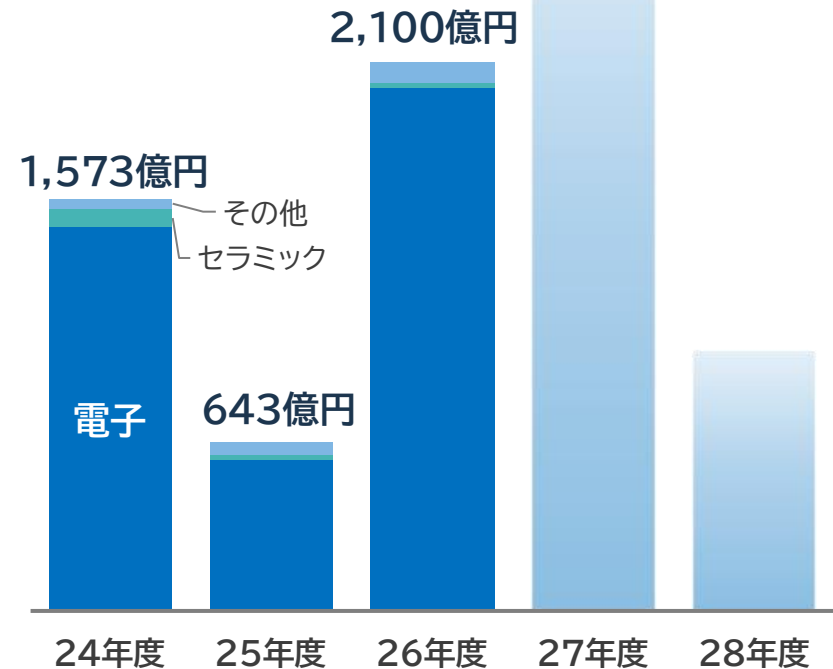


大野事業場 Cell8



設備投資額の推移

※ 26年度以降は会社計画
及び現時点での見通し

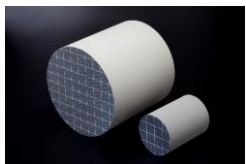


セラミック、その他:新たなビジネスの種まきを継続

- セラミック事業は、DPF(自動車排ガス浄化装置)に加えグラファイトで新市場の開拓を狙う
- その他事業では、次世代の収益源育成を目的として研究開発活動を積極的に推進する

セラミック事業

主な製品



DPF(ディーゼル・パティキュレート・フィルター)



AFP(触媒担体保持・シール材)



EVバッテリー用安全部材



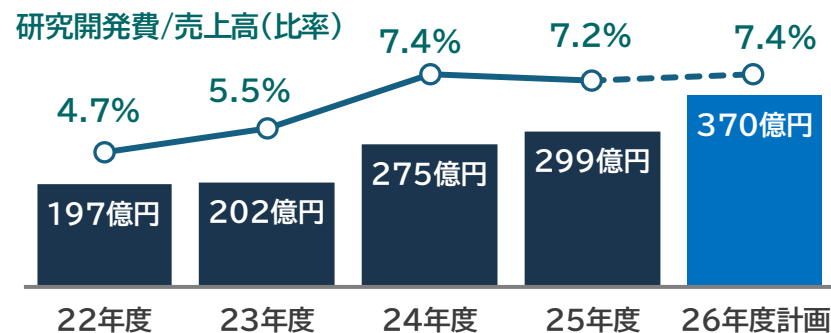
FGM(特殊炭素製品)

- ✓ **DPFやAFP**(内燃機関向け製品)は排気ガスの浄化に貢献。**PHEVと新興国の建機/農機での受注獲得**を狙う
- ✓ **EVバッテリー用安全部材**は、車載電池の間に挟み、発火などの電池事故の被害拡大を防ぐ。**海外での採用車種増加**を目指す
- ✓ **FGM**(特殊炭素製品)は、半導体製造装置のほか、北米の**次世代原子力市場を開拓**へ

その他・新事業

- ✓ 電動車(EV、PHEV、FCEV等)向け部材や、**ロボットの駆動分野での事業強化**を狙った研究開発を推進する
- ✓ 新たな事業領域として、**植物活性化剤「LEAF ENERGY」の育成**を進めるほか、CO₂固定化技術などに注目
- ✓ **新事業を創出する研究開発**も推進

研究開発費(全社ベース)の推移



05

企業価値向上の取り組み

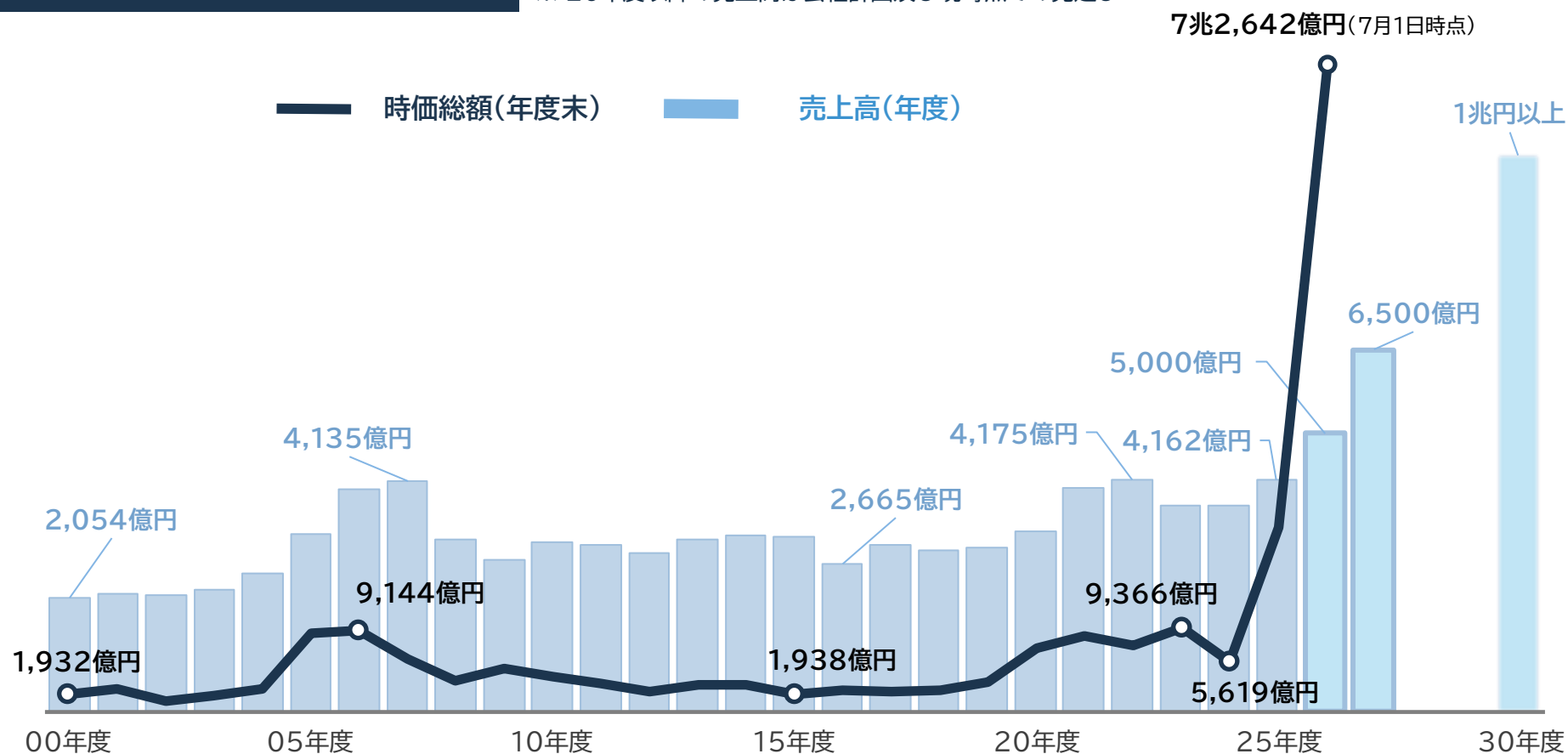


株式時価総額: 2026年に初めて7兆円を突破

- AI半導体と当社のICパッケージ基板への成長期待に後押しされ、時価総額は7兆円を突破
- 今後も成長戦略の実行を通じた利益拡大により、持続的な企業価値の向上を目指す

時価総額と売上高の推移

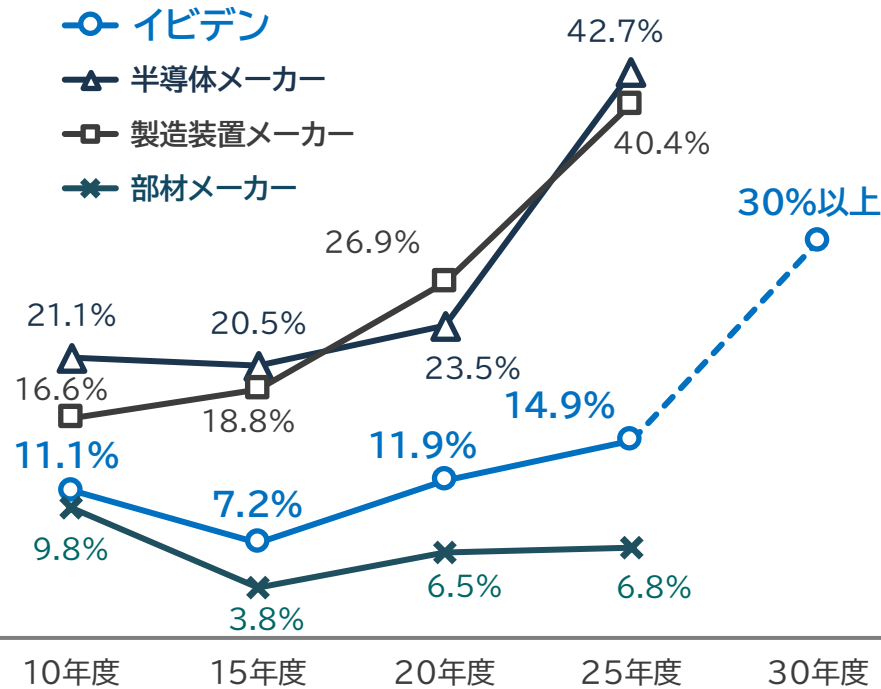
※ 26年度以降の売上高は会社計画及び現時点での見通し



企業価値向上へ：財務規律ある成長投資で収益力を強化

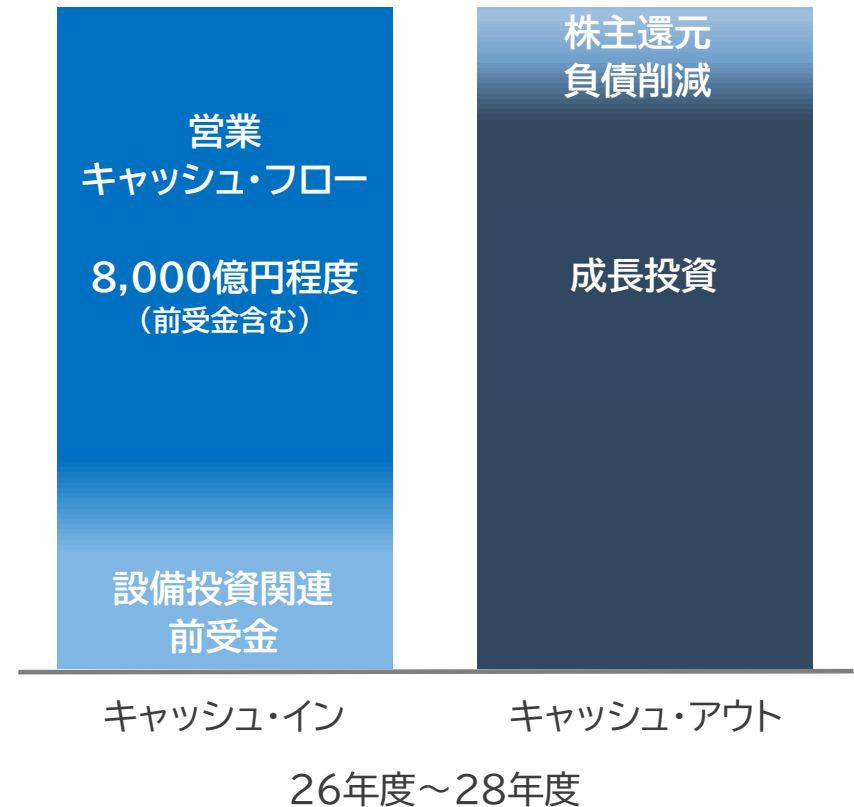
- 30年度に向けて営業利益率30%が視野に。将来的には更に高い収益性を目指せる体制へ
- 財務規律や株主還元とのバランスへ配慮しながら、企業価値向上に向けた成長投資を継続する

営業利益率の推移と今後のターゲット (半導体業界比較)



※ 半導体メーカーは、エヌビディア、ブロードコム、クアルコムの平均
 ※ 製造装置は、アドバンテスト、ディスコ、ASMLホールディングスの平均
 ※ 部材メーカーは、国内外の半導体部材メーカー複数社の平均

キャッシュ・アロケーション (現金収入と資金使途)



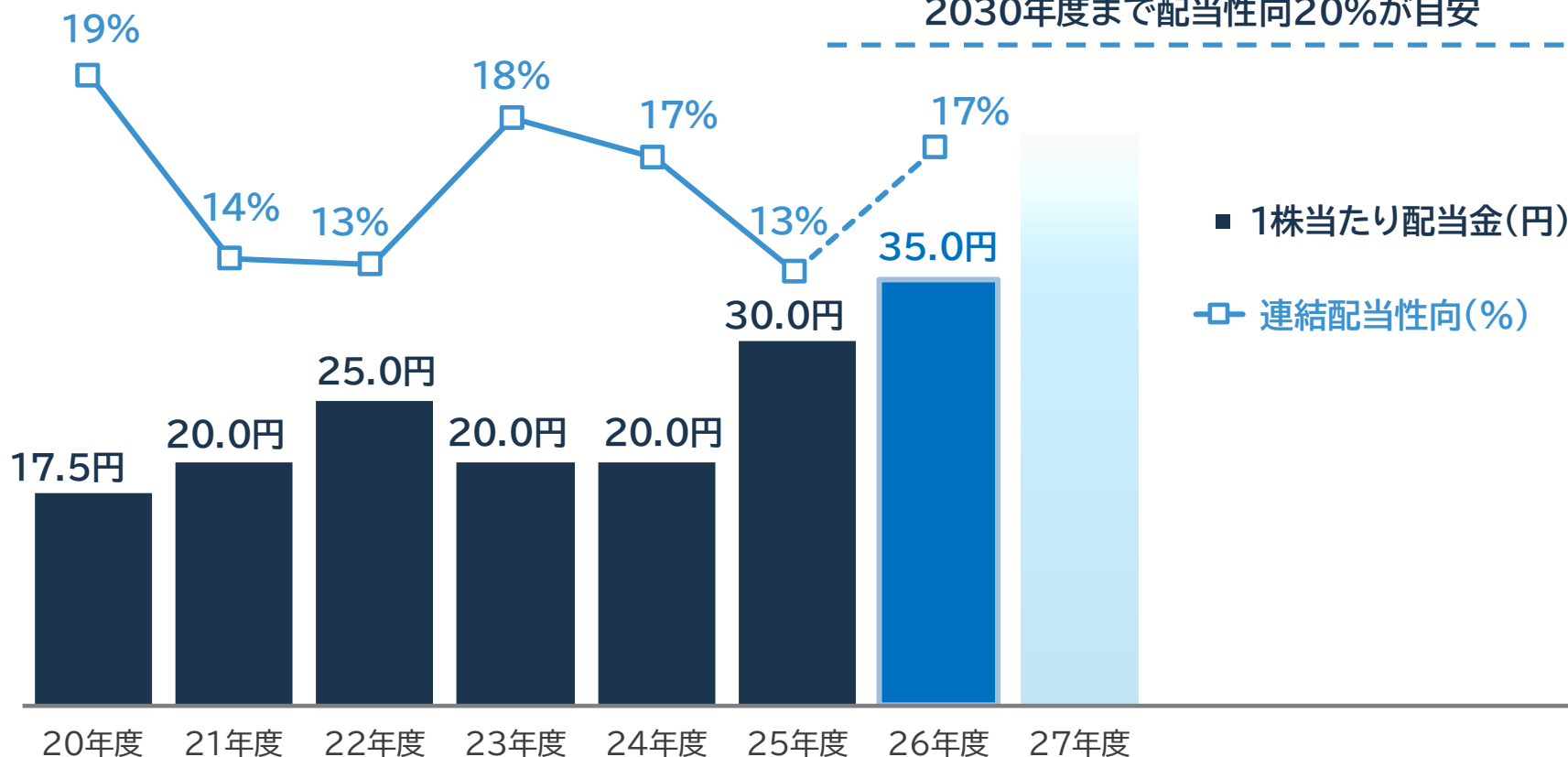
株主還元:配当は累進配当の方針を継続

- 株主還元については、配当性向20%を目安とし、累進配当とする方針(2030年度まで)
- 2026年度の1株当たり配当金額は35円(2025年度比+5円)を計画

1株当たり配当金と連結配当性向の推移

※ 26年度以降は会社計画及び現時点での見通し

2030年度まで配当性向20%が目安



本日のまとめ

- ✓ 時代の変化を予見し、新たな価値の創造に挑戦します
- ✓ 独自の技術により、高い競争優位性を確立します
- ✓ 成長投資と株主還元を両立します

<将来の見通しに関する注意事項>

本資料には、イビデン株式会社(以下「当社」)の業績見通し、経営計画、戦略など、将来に関する記述が含まれています。これらは本資料の作成時点で入手可能な情報に基づく当社の判断・仮定によるものであり、半導体等の市場動向、為替相場の変動、原材料価格や設備投資環境の変化、その他さまざまなリスクや不確実性を含んでいます。そのため、実際の業績等は、これらの将来見通しと大きく異なる可能性があります。当社は、新たな情報や将来の事象等により、本資料中の将来見通しを更新・修正する義務を負うものではありません。本資料は投資の勧誘を目的としたものではありません。投資に関するご決定は、ご自身のご判断において行っていただきますようお願いいたします。

ともに歩む、その先の革新へ



株主・投資家向けウェブサイト
<https://www.ibiden.co.jp/ir/>

